

08384204

本図は金型図基準(D11P007)に則っています

NOTE

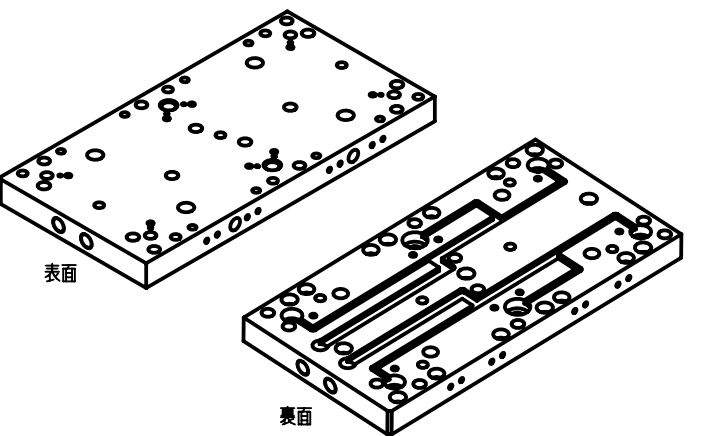
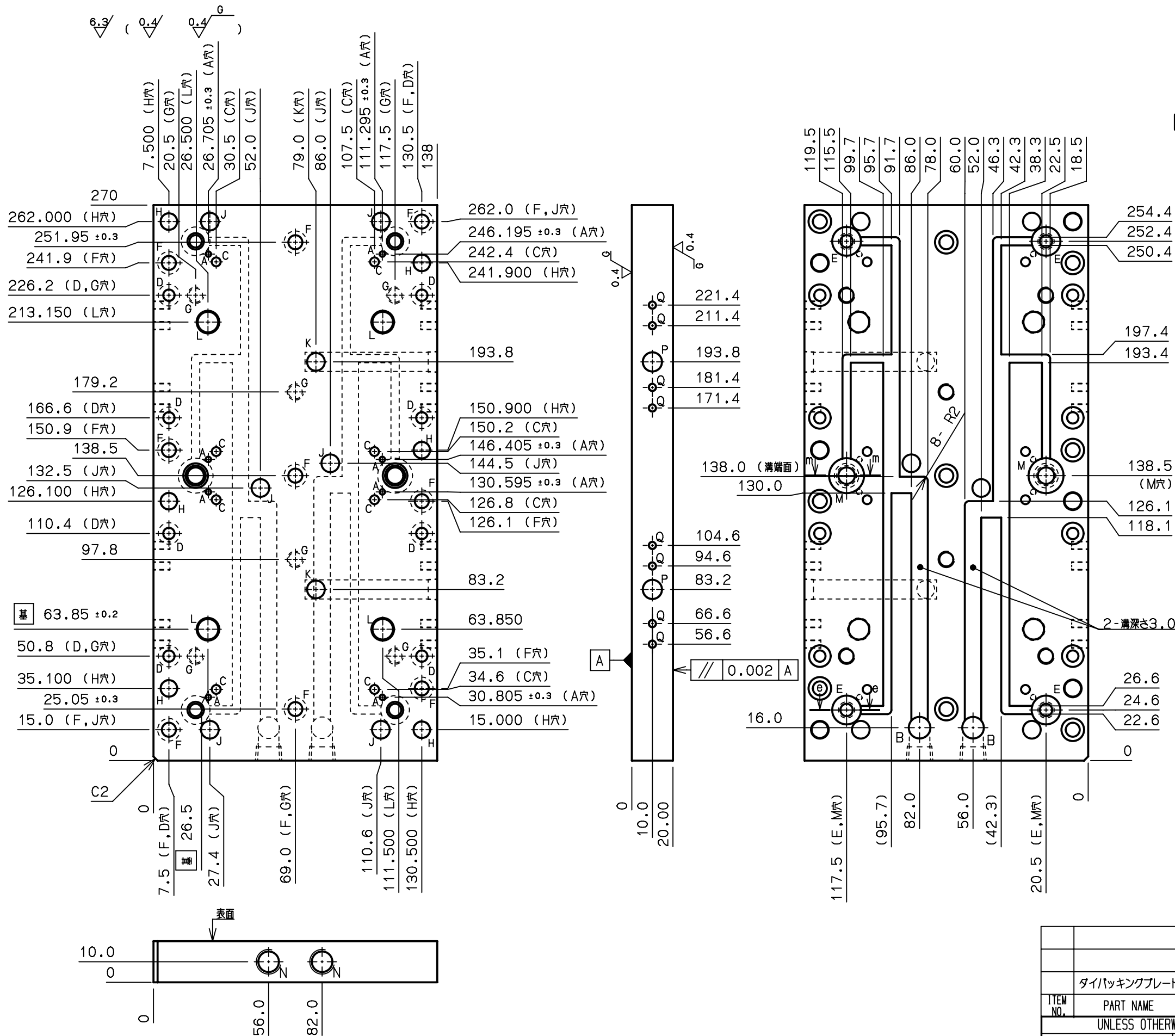
注1) メーカー:リヒト精光(株)、熱処理条件:HQ1025℃ HSZ-110℃ HT480℃ HT420℃(HRC62±1)
備考1) プレート外周はC0.5面取りのこと。

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

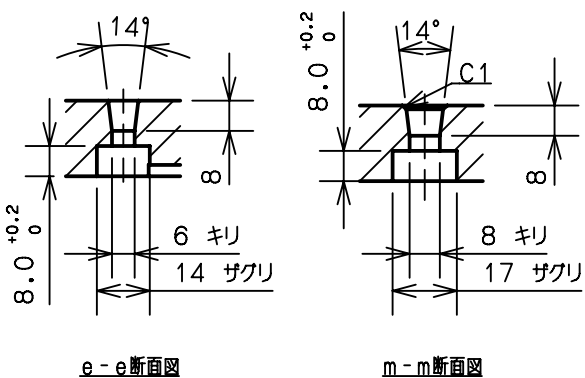
TAP POSITION ± 0.3
HOLE POSITION ± 0.3

全面書換え	3.8'22	大阪谷
E, M穴変更	3.15'21	大阪谷
CODE	NOTES	DATE BY
REVISIONS		

			(注1)			
	ダイパッキングプレート	DC53	QTS	1		
ITEM NO.	PART NAME	MATERIAL	FINISH	Q'ty	DESCRIPTION	MACHINE HISTORY
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:				DATE	BLOCK NAME	
TOLERANCES		ANGLE ± 0.5°		1. 19 21		
. ±0.5		CORNER R 0.3max C 0.2max		SCALE 1 / 2	LOT NO.	
.# ±0.2						
.** ±0.01						
*** ±0.002						
CONFIDENTIAL		DE.	DR.	DWG. NO.		
2022.03.25		大阪谷	大阪谷	XAM176-0212		B



外観図(FREE)



- A 8-M3 深6
- B 2-10.5キリ 深16(裏より)(貫通可)
- C 8-4.3キリ
- D 8-5.5キリ 10ザグリ 深7(裏より)
- E 4- e-e断面図参照
- F 9-6.8キリ 11ザグリ 深8(裏より)
- G 6-M8 深15(裏より)
- H 6-φ8.005^{0.4/} (上面C0.3)、8.6キリ 深10(裏より)
- J 6-8.6キリ
- K 2-8.6キリ 深8.5(P穴に貫通させること)
- L 4-φ10.005^{0.4/} (下面C0.3)、11キリ 深8
- M 2- m-m断面図参照
- N 2-R61/4 (下穴はB穴に貫通させること)
- P 2-R61/8 (下穴はK穴に貫通させること)
- Q 16-M4 深8(反対面から)